



TG395 单组分导热硅凝胶

TG395 导热凝胶是一种单组份可固化的导热凝胶。主要用于芯片级热界面材料 (TIM1)，降低芯片与均热板之间的热阻。

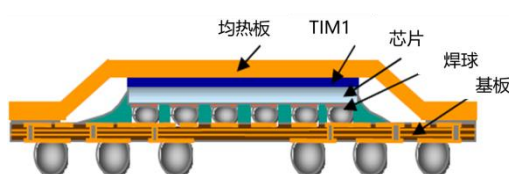
产品描述

产品特征

条目	描述
技术类型	有机硅
外观	灰色膏状
典型应用	倒装芯片 (FC-BGA) 封装 (CPU,GPU) 新能源汽车 其他电子设备, 用于冷却电子元件, 延长使用期, 有助于将现场使用的科学仪器和军事设备保持恒定温度。

产品优点:

- 低的界面热阻 (通过高的导热系数和薄的 BLT 实现)
- 良好的粘接性
- 良好的可操作性 (适合低粘度点胶工艺)
- 适中的模量
- 低的挥发量
- 良好的可靠性



产品性能

条目	典型值	备注
固化前		
粘度(Pa.s@5s ⁻¹)	330	ASTM D2196
触变指数	5-6	ASTM D2196
固化 (125°C/90min) 后		
硬度 (Shore 00)	~60	ASTM D2240
比重	2.45	ASTM D792
导热系数 (w/m.k)	3.9±0.1	ASTM D5470
热阻(K·cm²/W)	0.06±0.01	ASTM D5470 80psi



模量(kpa)	40	ASTM D412
拉伸断裂伸长率 (%)	150	ASTM D412
击穿强度 (V/mm)	72	ASTM D149
体积电阻率 $\Omega\cdot\text{cm}$	8×10^{10}	ASTM D257
介电常数	57	ASTM D150 @1MHZ
耗散因数	0.0024	ASTM D150 @1MHZ
挥发份 (%)	<0.4	150°C/3h
连续使用温度 (°C)	-40 ~ 150	/

可靠性能

项目	条件	数据/图表
回流焊测试	260°C *3 次	Si/TIM/Lid, TIM1 厚度~65um 压力: 40psi
烘烤测试	150 °C , 1000 小时	
湿热测试	135 °C & 85%RH , 256 小时	
高低温循环	-55 °C ~125 °C , 700 cycle	
热阻变化率 < 10%		



使用指南

从冷冻状态下取出，放置 2 小时恢复至室温。使用自动点胶机点胶时，设置好出胶量及点胶路径施胶到发热源元件面上，然后与散热元件压合好即可，若需要返修或多余的胶料可以用无尘布轻易擦掉。

标准包装

- 10ml/支, 30ml/支, 60ml /罐
- 根据客户要求

产品储存

本产品无毒性、无危险性，遵循标准化学品运输和储存。

将产品存贮于未开封的原装容器内，并存放在干净、干燥的区域。存储信息同时标注于产品外包装标签。

储存温度：-20°C低温冷冻保存，有效存储期为 6 个月。

为防止未使用产品受到污染，请不要将任何材料放回原装容器。本公司不对在所述情况以外的条件下被污染或储存的产品承担责任。更具体的保存期限信息，请咨询 Hanlicon 应用工程师。

注：本文中所含的各种数据仅供参考。对于任何人采用我们无法控制的方法得到的结果，我们恕不负责。自行决定把本产品用在本文中提及的产品应用外，及未采取本文中提及的措施来防止产品在贮存和使用过程中可能发生的损失和人身伤害都是用户自己的责任。本公司明确声明对所有因销售公司产品或特定场合下使用本公司产品而出现的问题，包括针对某一特殊用途的适用性问题，我们不承担责任。公司明确声明对任何必然的或意外损失都不承担责任。建议用户每次在正式使用前都要根据本文提供的数据先做实验。

湖南创瑾科技有限公司

中国湖南省长沙市宁乡经济技术开发区谐园北路

中国长沙智能终端产业园 5 号栋

Tel: +86-731-87827556

www.trumjin.com